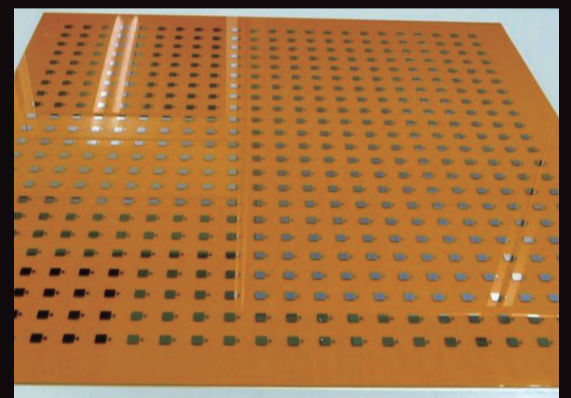
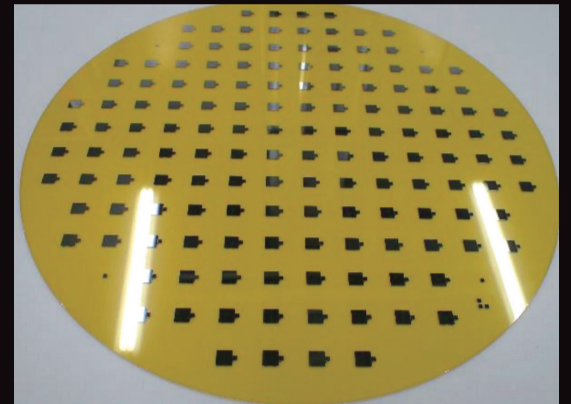


半導体パッケージング (WLP/PLP)用基板ガラス

Fan-Out Carrier Glass Substrate for Advanced WLP/PLP Semiconductor Packaging

特徴 FEATURES

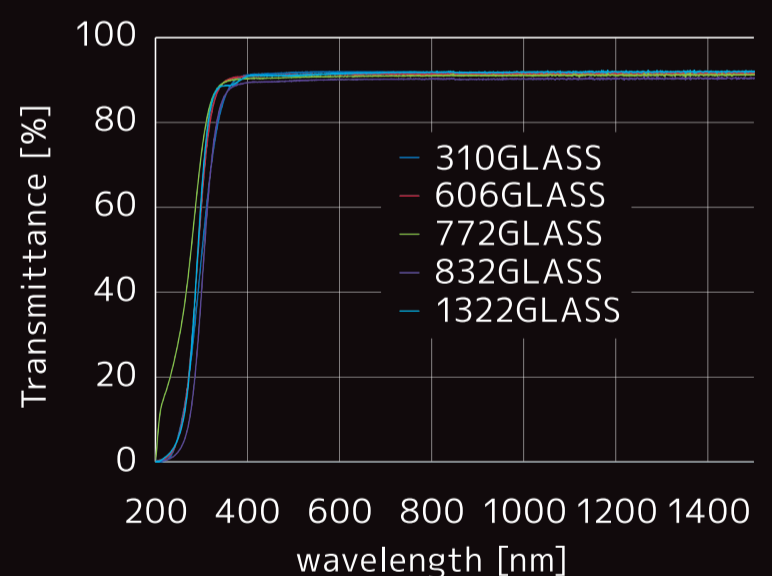
- ・広範囲の熱膨張係数ガラス (無アルカリガラス最高CTE: 8.2ppm/K)
Broad Variety of CTE (Alkali-free glass up to 8.2ppm/K)
- ・高平坦度、平滑度
High Flatness, Smoothness
- ・高品位端面加工
Edge treatment with less micro crack
- ・ノッチ・オリフラ・IDマーク
Orientation flat in corner, Notch, Serially numbering
- ・低挿入損失、良好な電気特性
Low Insertion Loss, Excellent Electrical property
- ・高透過率
High Transmittance



協力: TOWA, 富士機械, DNP
Courtesy of TOWA, FUJI MACHINE and DNP

技術データ TECHNICAL DATA

Item	Specification
Size line up	Φ6, 8, 12inch / Up to approx. Gen.3
Thickness	0.4~1.8mm
TTV	3, 5, 10μm / 10μm~
Ra	≤0.5~2.0nm
Young's modulus	70~85GPa
Relative permittivity@10GHz	5.0~8.0
Loss tangent@10GHz	0.005~0.006



用途 APPLICATIONS

- ・キャリアガラス(WLP)
Fan-Out Wafer Level Package
- ・キャリアガラス(PLP)
Fan-Out Panel Level Package
- ・バックグラインド用サポート基板
Back Grinding Supporting
- ・高周波デバイス
RF Device
- ・μディスプレイ
u Display
- ・インターポージャー
Glass Interposer
- ・イメージセンサー
CMOS Image Sensor